

檔 號：

保存年限：

中華民國創業投資商業同業公會 函

地址：台北市松山區民生東路四段133號
10樓C室

聯絡人：劉其傑

電話：02-2545-0075 分機546

傳真：02-2713-2362

電子郵件：angel.liu@tvca.org.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國115年6月18日

發文字號：台創字第1150000557號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1

主旨：檢送「2026台灣創投年會」活動資訊一案，活動訂於115年7月7日(二)至8日(三)舉行，報名自即日起至115年7月8日(三)，敬請貴校協助轉知所屬育成中心及相關單位，並鼓勵踴躍參與，請查照。

說明：

- 一、為促進我國新創產業發展與國際接軌，並加強創投與新創團隊間之交流與合作，由創投公會(TVCA)與私募公會(TPEA)共同舉辦「2026台灣創投年會」，邀請產官學研各界領袖共聚一堂，深入探討新創成長關鍵與最新產業趨勢。
- 二、本屆年會以「BEYOND」為核心主題，包含半導體新賽局、低軌衛星、AI人工智慧、精密製造等，講者陣容有鴻海劉揚偉董事長、中華精測、昇達科技、倍利科技、川湖、貝爾威勒等知名成功創業家，以及首次舉辦"Asia VC Summit"，邀請日、韓創投公會理事長及國際投資人，將帶您深入掌握產業觀點與投資洞見。
- 三、旨揭活動將於115年7月7日(星期二)至7月8日(星期三)假台北文創14樓、6樓及誠品表演廳B1舉行，活動報名期間自即日起至115年7月8日(三)，敬請貴校惠予協助轉知所屬育成中心及相關單位，鼓勵踴躍報名參與，活動詳情請參閱官方網站：tvca-summit.tvca.org.tw。
- 四、檢附本次活動文宣及宣傳圖片，詳如附件，敬請查照。

正本：學校及育成中心

副本：